

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成 18 年 6 月 8 日 (2006.6.8)

【公表番号】特表 2005-524109 (P2005-524109A)

【公表日】平成 17 年 8 月 11 日 (2005.8.11)

【年通号数】公開・登録公報 2005-031

【出願番号】特願 2004-500334 (P2004-500334)

【国際特許分類】

G 0 9 F 9/30 (2006.01)

【 F I 】

G 0 9 F 9/30 3 3 0 Z

G 0 9 F 9/30 3 1 0

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 4 月 14 日 (2006.4.14)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

可撓性ディスプレイ装置であって、
電気ディスプレイ部品を備えた上面と、底面とを有し、前記上面から前記底面までを通り抜ける開口部を備えた可撓性基板と、
前記底面に結合された導電層と、
導電要素と、
を備え、
前記開口部が、前記導電層の少なくとも一部を露出させ、
前記導電要素により前記開口部を充填して、前記導電層の少なくとも一部に対する第 1 電気接触部と、前記可撓性基板上の前記電気ディスプレイ部品に対する第 2 電気接触部とが形成された、
ことを特徴とする可撓性ディスプレイ装置。

【請求項 2】

可撓性ディスプレイ装置であって、
上面を備え、該上面はこれを通り抜ける開口部を有し、電気ディスプレイ部品を備えた可撓性基板と、
前記上面の下方に配設された導電層と、
導電要素と、
を備え、
前記開口部が、前記導電層の少なくとも一部を露出させ、
前記導電要素により前記開口部を充填して、前記導電層の少なくとも一部に対する第 1 電気接触部と、前記可撓性基板上の前記電気ディスプレイ部品に対する第 2 電気接触部とが形成された、
ことを特徴とする可撓性ディスプレイ装置。

【請求項 3】

可撓性無線識別 (R F I D) 装置であって、
電気 R F I D 部品を備えた上面と、底面とを有し、前記上面から前記底面までを通り抜ける開口部を備えた可撓性基板と、

前記底面に結合された導電層と、
導電要素と、
を備え、

前記開口部が、前記導電層の少なくとも一部を露出させ、
前記導電要素により前記開口部を充填して、前記導電性領域の少なくとも一部に対する第1電気接触部と、前記可撓性基板上の前記電気RFID部品に対する第2電気接触部とが形成された、
ことを特徴とする可撓性無線識別(RFID)装置。

【請求項4】

可撓性無線識別(RFID)装置であって、
上面を備え、該上面はこれを通り抜ける開口部を有し、電気RFID部品を備えた可撓性基板と、
前記上面の下方に配設された導電層と、
導電要素と、
を備え、

前記開口部が、前記導電層の少なくとも一部を露出させ、
前記導電要素により前記開口部を充填して、前記導電層の少なくとも一部に対する第1電気接触部と、前記可撓性基板上の前記電気RFID部品に対する第2電気接触部とが形成された、
ことを特徴とする可撓性ディスプレイ装置。

【請求項5】

可撓性電子装置であって、
電気部品を備えた上面と、底面とを有し、前記上面から前記底面までを通り抜ける開口部を備えた可撓性基板と、
導電要素と、
を備え、
前記底面が導電性領域を備え、前記開口部が前記導電性領域の少なくとも一部を露出させ、

前記導電要素により前記開口部を充填して、前記導電性領域の少なくとも一部に対する第1電気接触部と、前記可撓性基板上の前記電気部品に対する第2電気接触部とが形成された、
ことを特徴とする可撓性電子装置。

【請求項6】

可撓性電子装置であって、
上面を備え、該上面はこれを通り抜ける開口部を有し、電気ディスプレイ部品を備えた可撓性基板と、
前記上面の下方に配設された導電層と、
導電要素と、
を備え、

前記開口部が、前記導電層の少なくとも一部を露出させ、
前記導電要素により前記開口部を充填して、前記導電層の少なくとも一部に対する第1電気接触部と、前記可撓性基板上の前記電気部品に対する第2電気接触部とが形成された、
ことを特徴とする可撓性電子装置。

【請求項7】

可撓性ディスプレイ装置を製造する方法であって、
可撓性ディスプレイ装置の一部を形成する可撓性基板の上面に開口部を形成する工程であって、前記可撓性基板が導電層を含む底面を有し、前記開口部が前記導電層の少なくとも一部を露出させる、前記工程、
前記導電層の少なくとも一部に対する電気接触部を形成する導電性材料で前記開口部を

充填する工程であって、前記導電性材料が更に前記上面にある電気ディスプレイ部品に対する電気接触部を形成する、前記工程、を含む、前記方法。

【請求項 8】

可撓性ディスプレイ装置を製造する方法であって、

可撓性ディスプレイ装置の一部を形成する可撓性基板の上面に開口部を形成する工程であって、前記可撓性基板が前記上面の下方に配設された複数のコンダクタを有し、前記開口部が前記複数のコンダクタの少なくとも一部を露出させる、前記工程、

前記複数のコンダクタの少なくとも一部に対する電気接触部を形成する導電性材料で前記開口部を充填する工程であって、前記導電性材料が更に前記上面にある電気ディスプレイ部品に対する電気接触部を形成する、前記工程、を含む、前記方法。

【請求項 9】

可撓性 R F I D 装置を製造する方法であって、

可撓性 R F I D 装置の一部を形成する可撓性基板の上面に開口部を形成する工程であって、前記可撓性基板が導電性領域を含む底面を有し、前記開口部が前記導電性領域の少なくとも一部を露出させる、前記工程、

前記導電性領域の少なくとも一部に対する電気接触部を形成する導電性材料で前記開口部を充填する工程であって、前記導電性材料が更に前記上面にある電気部品に対する電気接触部を形成する、前記工程、を含む、前記方法。

【請求項 10】

可撓性 R F I D 装置を製造する方法であって、

可撓性電子装置の一部を形成する可撓性基板の上面に開口部を形成する工程であって、前記可撓性基板が前記上面の下方に配設された複数のコンダクタを有し、前記開口部が前記導電層の少なくとも一部を露出させる、前記工程、

前記複数のコンダクタの少なくとも一部に対する電気接触部を形成する導電性材料で前記開口部を充填する工程であって、前記導電性材料が更に前記上面にある電気部品に対する電気接触部を形成する、前記工程、を含む、前記方法。

【請求項 11】

可撓性電子装置を製造する方法であって、

可撓性電子装置の一部を形成する可撓性基板の上面に開口部を形成する工程であって、前記可撓性基板が導電性領域を含む底面を有し、前記開口部が前記導電性領域の少なくとも一部を露出させる、前記工程、

前記導電性領域の少なくとも一部に対する電気接触部を形成する導電性材料で前記開口部を充填する工程であって、前記導電性材料が更に前記上面にある電気部品に対する電気接触部を形成する、前記工程、を含む、前記方法。

【請求項 12】

可撓性電子装置を製造する方法であって、

可撓性電子装置の一部を形成する可撓性基板の上面に開口部を形成する工程であって、前記可撓性基板が前記上面の下方に配設された複数のコンダクタを有し、前記開口部が前記複数のコンダクタの少なくとも一部を露出させる、前記工程、

前記複数のコンダクタの少なくとも一部に対する電気接触部を形成する導電性材料で前記開口部を充填する工程であって、前記導電性材料が更に前記上面にある電気部品に対する電気接触部を形成する、前記工程、を含む、前記方法。